

プラナリゼーション CMP とその応用(1)

9月16日 13:40~15:20 A室

A15・A16 (キーノートスピーチ)

環境対応車における SiC 半導体に対する期待

○藤原広和・味岡正樹・長尾 勝・川井文彰・濱田公守 (トヨタ自動車)

A17

革新的 CMP/P-CVM 融合装置の設計・試作 (第 4 報) —A-type 装置による炭化ケイ素を加工対象とした平坦化特性の評価—

○塩澤昂祐・佐野泰久 (大阪大)・土肥俊郎・黒河周平 (九州大)・會田英雄 (並木精密宝石)・宮下忠一・住澤春男 (不二越機械工業)・山内和人 (大阪大)

A18

革新的 CMP/P-CVM 融合加工装置の設計・試作 (第 5 報) —B-Type 装置による各種難加工材料の基本的加工特性とその評価—

○大山幸希 (並木精密宝石)・土肥俊郎 (九州大)・佐野泰久 (大阪大)・黒河周平 (九州大)・會田英雄 (九州大, 並木精密宝石)・塩澤昂祐 (大阪大)・宮下忠一 (不二越機械工業)・金 聖祐 (並木精密宝石)

A19

紫外線照射による新規ナノ炭素微粒子を用いた難加工材研磨手法に関する研究

○村川 渉・鈴木恵友・カチヨーンルンルアンパナート (九工大)

プラナリゼーション CMP とその応用(2)

9月16日 15:40~17:00 A室

A21

GaN 基板の平坦化加工技術 (第一報) —高品位の研削と CMP—

○伊東利洋・山本栄一 (岡本工作機械製作所)・金安 充 (マイテック)

A22

紫外光を援用した触媒表面基準エッチング法による窒化ガリウム・炭化ケイ素基板の高効率平坦化加工

○山口 航・磯橋 藍・杉浦崇仁・稲田辰昭・松山智至・佐野泰久・山内和人 (大阪大)

A23

触媒表面基準エッチング法における白金に代わる新規触媒の検討

○磯橋 藍・稲田辰昭・山口 航・杉浦崇仁・松山智至・佐野泰久・山内和人 (大阪大)

A24

研磨技術を用いたサファイア加工基板のパターン形状制御—パターン形状と LED 性能の関係—

プラナリゼーション CMP とその応用(3)

9月17日 9:20~10:20 A室

A32・A33（キーノートスピーチ）

研磨シミュレーションの変遷

○宇根篤暢（防衛大）

A34

Si-CMPにおける研磨装置の挙動解析と研磨特性との関係—機械的作用と化学的作用のインターラクション考察—

畝田道雄・○高橋佳宏（金沢工大）・澁谷和孝・中村由夫・市川大造（不二越機械工業）・石川憲一（金沢工大）

プラナリゼーション CMP とその応用(4)

9月17日 10:40~12:00 A室

A36

SiC単結晶の酸化剤援用研磨の研究（3）

佐藤 誠・○大森 恒・高橋舞子・山口貴哉（ノリタケカンパニーリミテド）

A37

研磨圧カシミュレーションにおいて各種モデル化が解析精度に与える影響

○橋本洋平・鈴木教和・沈 関・社本英二（名古屋大）

A38

レーザーアシスト延性加工によるシリコンの平坦化（第3報）—臨界切り込み量の結晶方位依存性に対する熱援用切削の効果—

○山信田博紀・武田秀俊・會田英雄（並木精密宝石）

A39

Hybrid X-FROG法を用いたウェハ表面の非接触光計測技術に関する研究

○林 照剛・横尾英昭・王 成武・松川洋二・黒河周平（九州大）

プラナリゼーション CMP とその応用(5)

9月17日 13:00~14:20 A室

A43

CMP加工による超硬の刃先仕上げとその刃先を用いた切削加工の研究

○田中弥生・江龍 修（名古屋工大）・青木 渉（BTT）・神田隆生（ポパール興業）

A44

ファイバードレッサによるパッドドレッシングの有効性評価とそのメカニズム—ファイバードレッサとダイヤモンドドレッサの寿

命評価試験一

畝田道雄・○高橋直紀（金沢工大）・新井雄太郎（昭和工業）・藤田 隆（東京精密）

A45

小径工具を用いたスラリー流れ制御型研磨（第1報）—新型工具の加工特性—

○吉富健一郎・餅田正秋・多田一生・宇根篤暢（防衛大）

A46

CMPにおけるウェーハ・研磨パッド間スラリー流れの可視化

○御手洗真人・福田 明（徳山高専）